

12月1日(火)、2日(水)電子デバイス研修講座(基礎編)(中級編):WEB併用

第3回電子デバイス研修講座(基礎編):WEB併用		第1回電子デバイス研修講座(中級編):WEB併用	
キャッチフレーズ	～電子デバイスとは何だ～ ～これだけ知っていれば、あなたも電子デバイス関係者だ!～	～電子デバイス分野で更なる活躍を目指すあなたへ!～ ～中級編でもう一歩先に進もう!～	
対象者	本年の新入社員の方、電子デバイス産業及び関連産業に関わりたい、また関わって間もない方を対象として、電子デバイス関係者とのコミュニケーションを取れることを目指す。	・理系の入社後3～5年の方について、電子デバイス全般の常識的素養を得ることを目指す。 ・営業職、販売職の方について、顧客との実戦の場で、電子デバイスに関するやり取りが十分行えることを目指す。	
会場	日本教育会館 喜山倶楽部 飛鳥の間	日本教育会館 喜山倶楽部 光琳の間	
WEB参加の場合	Teamsを使用してURLを送付し、接続していただきます。	Teamsを使用してURLを送付し、接続していただきます。	
12月1日 (火)	10:10-10:50 電子デバイスの歴史と応用分野 釜原 紘一 NEDIA監事、人材育成研修委員会副委員長、元三菱電機株	10:10-10:55 電子デバイス産業の市場動向からみた経営戦略 齋藤昇三 NEDIA代表理事・会長 株デバイス&システムプラットフォーム開発センター 代表取締役会長 兼 社長、株東芝 囀託	
	電子部品(抵抗・コンデンサ等の受動部品)、半導体(ダイオード・トランジスタ等の個別半導体、LED等の光半導体、マイコン・メモリ等のLSI)、ディスプレイ(LCD、EL、CRT)などからなる電子デバイスの発展の歴史を振り返り、それらが様々な電子機器に使われるようになってきた歴史と現状を概観する。	超スマート社会の実現のためにできたトランスフォーメーション(DX)の加速が必要となり、それを支える電子デバイス産業の市場は大きく変化し、拡大している。この市場動向からみた日本の電子デバイス産業が勝つための経営戦略について解説する。	
	11:00-11:50 半導体とは 西久保靖彦 ウェストブレイン 代表	11:05-11:50 これからの電子デバイス、技術と応用 松本哲郎 NEDIA人材育成研修委員会副委員長、Z2A企画 代表	
	半導体の材料・特性・デバイス ①半導体の特質、②P型、N型半導体とMOSトランジスタ、③MOSトランジスタからLSIへ	これからのデジタル社会の基盤となるICT技術、それを支える電子デバイスの役割・価値と注目デバイスを解説する。	
	11:50-12:40 昼食・昼休み	11:50-12:40 昼食・昼休み	
	12:40-13:40 受動素子の種類及び特徴 安宅竜二 アルプスアルパイン株 回路技術第2グループ グループマネージャー	12:40-13:25 システムの中心を形作るマイコンとロジック 西村光太郎 NEDIA理事、人材育成研修委員長、株ブリパテック 相談役	
	受動電子部品機能と最新動向並び電気設計における基本留意事項の解説	開発競争が激化しているAIチップを含め、マイコンとロジックの要点を解説する。	
	13:50-14:50 半導体デバイス概要 西村光太郎 NEDIA理事、人材育成研修委員長、株ブリパテック 相談役	13:30-14:15 次世代メモリとその応用 松本哲郎 NEDIA人材育成研修委員会副委員長、Z2A企画 代表	
	メモリ・マイコン、ロジック、センサー等の主要半導体デバイスについて解説する。	変革するメモリの新しい時代について解説する。	
	15:00-15:40 電子デバイスの品質管理概要 釜原 紘一 NEDIA監事、人材育成研修委員会副委員長、元三菱電機株	14:20-15:05 モビリティ・インフラを支えるパワーデバイス 寺島知秀 三菱電機株 パワーデバイス事業所 専任	
	電子デバイスの品質の概要について、信頼性、故障メカニズム等について解説する。	パワーデバイスの基本動作を簡単に紹介した後、モビリティ・インフラを支える現在の主力デバイス(IGBT、SJ-MOSFET)と、今後大きな発展が予想されるSiCデバイスについて順を追って解説する。	
	15:50-16:50 電子デバイスの新しい技術及び応用 松本哲郎 NEDIA人材育成研修委員会副委員長、Z2A企画 代表	15:15-15:55 IoT・ロボット時代に必須のセンサーの実態 漆原育子 アーズ株 取締役	
	これからの世の中の新しい潮流により変化する電子デバイスについて解説する。	IoT・ロボットなどに利用されて各種センサと周辺回路部品とセンサシステム設計の例について解説する。	
	12月2日 (水)	10:00-12:00 半導体製造工程 西久保靖彦 ウェストブレイン 代表	10:00-11:00 今後の最先端半導体デバイスを導く最先端製造プロセス技術 東京エレクトロン株 デバイス技術企画部 メモリテクノロジープロジェクト プロジェクトリーダー 廣田良浩
半導体製造工程・製造装置・材料 ①半導体前工程(ウエーハプロセス)、②半導体後工程(実装・組立工程)、③半導体の微細化はどこまで?		DRAM、NAND Flash、Logicに代表される最先端半導体デバイスの構造とその製造プロセス技術の全体像(プロセスフロー)を解説する。これら最先端デバイスのビット密度向上、微細化のためのプロセス技術的チャレンジや推測される今後の技術動向を紹介する。さらに、それらを実現するために必要な代表的な最先端製造プロセス技術について紹介する。	
12:00-12:50 昼食・昼休み		11:10-11:55 デバイスを活かす組込みソフトウェアの実態 神原弘之 公益財団法人 京都高度技術研究所 研究開発本部 ICT研究開発部 部長	
12:50-13:55 電子デバイスの実装概要 加藤凡典 (有)AIT 代表取締役		巨大化への対応、セキュリティの確保などの組込みソフトウェアの課題について解説する。	
半導体パッケージング、モジュール、プリント基板、実装機 について解説する。		11:55-12:45 昼食・昼休み	
14:05-14:45 センサー・無線モジュール概要 漆原育子 アーズ株 取締役		12:45-13:25 電子デバイスの品質管理の実態 周藤仁吉 NEDIA常務理事・事務局長、元株日立製作所	
IoTシステムに欠かせないセンサー・無線モジュール・組込ボード・AIチップなどの現状とそれを使ったシステム構築、利用シーンについて解説する。		電子デバイスの信頼性向上へのアプローチ、故障への対応等の電子デバイス品質管理の実態について解説する。	
14:55-15:35 組込みソフトウェア概要 神原弘之 公益財団法人 京都高度技術研究所 研究開発本部 ICT研究開発部 部長		13:35-14:30 半導体を作る材料の進歩 西久保靖彦 ウェストブレイン 代表	
組込みソフトウェアが、電子デバイスを、どのように連携/機能させているかを解説する。		光・高速通信・パワー半導体向け材料について解説する。	
15:45-16:40 新しい時代を支える電子デバイスの全貌 齋藤昇三 NEDIA代表理事・会長 株デバイス&システムプラットフォーム開発センター 代表取締役会長 兼 社長、株東芝 囀託		14:40-15:35 最新の实装技術 加藤凡典 (有)AIT 代表取締役	
超スマート社会といわれる新しい時代が到来、これを支える電子デバイス産業の市場動向を解説し、日本が勝つための戦略を議論する。		実装技術の進化と重要性の変化、5G向けスマホの実装技術及び最新の重要技術について解説する。	
		15:45-16:40 2020年の世界半導体市場の動向と注目すべきトレンド 南川 明 Informa Tech(OMDIA) Senior Consulting Director	
		COVID19、米中摩擦下における市場を展望する。	